



SK – UA spolupráca pri obnove Ukrajiny

„Mechanizmy podpory obnovy Ukrajiny prostredníctvom slovenských subjektov“

Úvod

Slovensko poskytuje Ukrajine od začiatku ničím nevyprovokovanej masívnej vojenskej agresie Ruskej federácie proti nášmu priamemu susedovi politickú, diplomatickú, humanitárnu, ekonomickú a vojenskú pomoc a poskytuje bezpečné útočisko vojnovým utečencom z Ukrajiny na svojom území. Zachovanie štátnosti, zvrchovanosti a identity Ukrajiny je v našom národnom záujme.

Poverená vláda premiéra Ľ. Ódora sa v súlade so svojimi programovými prioritami zhostila úlohy vyplývajúcej aj zo záverov okrúhleho stola zo 7.7.2022 k zapojeniu Slovenska do procesov obnovy UA, vypracovať pre túto ambíciu podporné mechanizmy, ktoré by umožnili efektívnejšie využiť geografické výhody SR, podobne ako to robia viacerí susedia Ukrajiny, a vybudovať komerčnú nadstavbu k doteraz čisto donorskému modelu podpory. Takéto schémy, kompatibilné s finančnými externými obálkami, otvorené aj pre prípadných tretích donorov by umožnili slovenským subjektom aktívne sa zapojiť do medzinárodného úsilia pre obnovu vojnou ničeného hospodárstva Ukrajiny.

Materiál zahŕňa schémy dvoch mechanizmov, (i) Slovensko – Ukrajinský rámec pre podporu obchodu a investícií (SK – UA TISF, Trade and Investment Support Facility) a (ii) Slovensko – Ukrajinský rámec pre darcovské partnerstvá pri nenávratnej pomoci (SK-UA DPNA, Donor Partnerships for Non-returnable Aid).

Vypracoval Zbor poradcov predsedu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Európskou komisiou, Eximbankou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a Slovenským investičným holdingom.

Obsah materiálu (formou príloh)

1. Samotný materiál – Mechanizmy podpory obnovy Ukrajiny prostredníctvom slovenských subjektov. Koncept využitia nástrojov SK-UA TISF a SK-UA DPNA.
2. Podporná politika globálneho spoločenstva EÚ + G7 (v prílohe materiálu č. 1)
3. Príklady využitia mechanizmov (v prílohe materiálu č. 2)